Orbotech Diamond™ GWXL

应用于玻璃基板的白色防焊直接成像

Orbotech Diamond GWXL

Orbotech Diamond GWXL 是高产能高阶的防焊直接成像（DI）解决方案，专为应对玻璃基板上白色防焊应用的独特挑战而设计（例如 miniLED)。

Orbotech Diamond GWXL 是基于经业界验证的 Orbotech Diamond 10W 解决方案而设计的新一代产品。是用于白色防焊系统的专用机型，能够实现高品质成像及高产能。

采用 KLA 专利的 SolderFast™ 技术，Orbotech Diamond GWXL 提升了白色防焊直接成像的标准，在加强了成像精度及品质的同时减少了整体拥有成本（TCO)。

优势

高品质成像

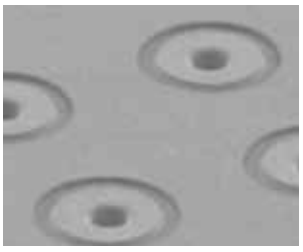
- 白色防焊在玻璃基板上的高品质成像
- 多波长可实现高品质侧壁及优异的表面品质
- 显著减少白色防焊的底切
- 高景深（DOF）适用于高低差大的表面

高产能，快速产出

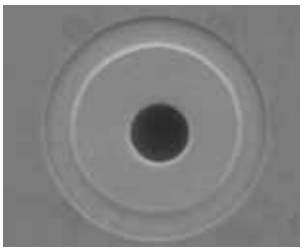
- 专利高能量照明光源
- 一次曝光成像，单次曝光即可完成全板均匀成像
- 双台面传输机制优化成像时间
- 实时靶点识别及捕捉功能
- 自动化就绪以用于玻璃处理

卓越的成像精度

- 对位精度高达 ±10µm
- 独特的对位方法用于被白色防焊遮盖住的靶点
- 高阶涨缩模式和算法，克服板材变异



高品质防焊成像



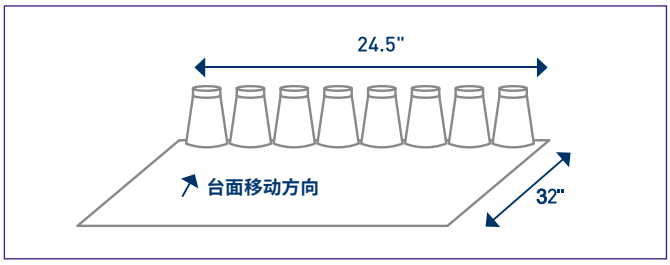
高对位精度

Orbotech Diamond GWXL
白色防焊桥，最小底切

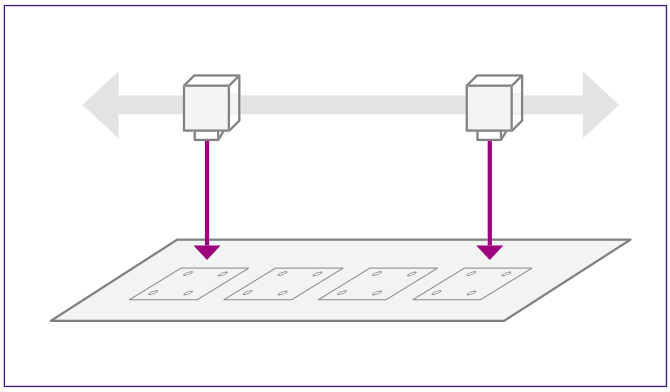
其他防焊直接成像方案
白色防焊桥，明显的底切

Technologies

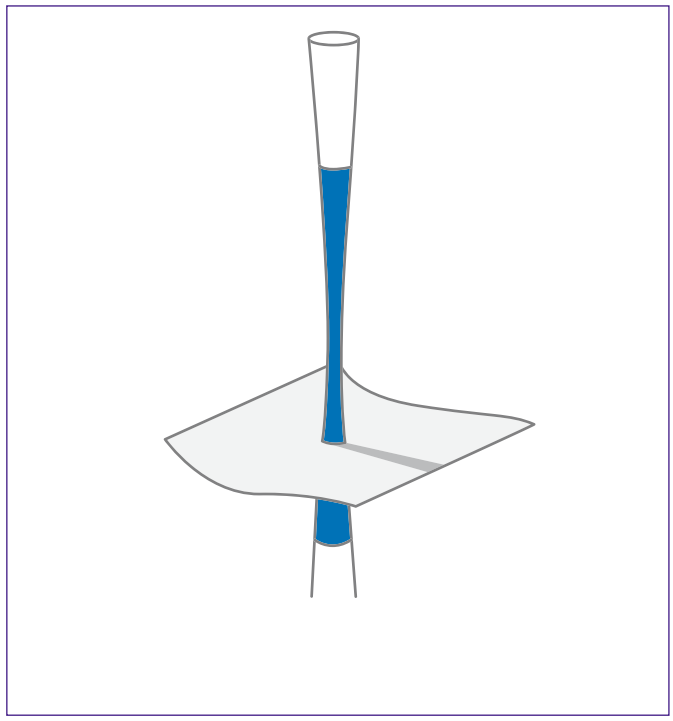
SolderFast™ Technology



一次成像实现快速产出，成像均匀且没有拼接问题



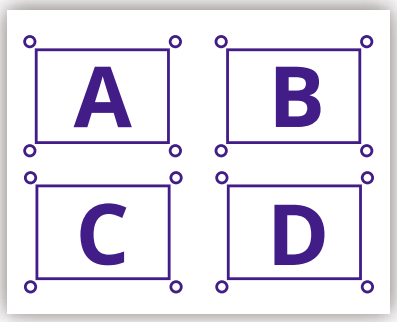
实时靶点识别及捕捉



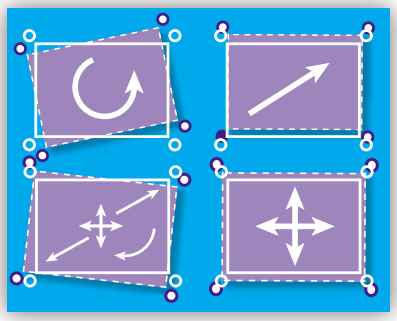
高景深（DOF）适用于高低差大的表面

卓越的成像精度

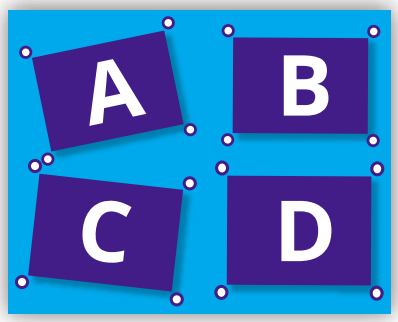
高阶涨缩模式和算法可以克服具有挑战性的板子变形，
包括自动涨缩，局部涨缩及非线性涨缩



数据



板子



图像

规格

最小开窗*	100µm
最小防焊桥*	75µm
对位精度**	±10µm
最大板子尺寸 (X/Y)	25” x 32” (635mm x 812mm)
最大曝光尺寸 (X/Y)	24.5” x 32” (622mm x 812mm)
曝光能量范围	50-2,200 mJ/cm^2
尺寸	高: 1,960mm 深: 3,315mm 宽: 1,900mm
重量	5,000Kg
应用	应用于玻璃基板的白色防焊曝光

*取决于防焊油墨类型及制程
**所有值均为 3σ

上述规格如有变更，恕不另行通知

KLA 支持
保持系统生产力是 KLA 良率优化解决方案不可或缺的一部分。包括系统维护、全球供应链管理、降低成本和减少报废、系统迁移、性能和生产率提升以及转售认证设备。

©2022 KLA 公司。所有品牌或产品名称可能为其各自公司的商标。KLA 保留在不另行通知的情况下更改硬件和/或软件规格的权利。

KLA Corporation
www.orbotech.com/pcb | www.kla.com

Rev 1_3-10-2022